



Since 1946
Brightening the Future

2022年度(2023年3月期) 第1四半期決算概要について

新光電気工業株式会社



目次

2022年度 第1四半期決算概要（連結）

決算概況	2
プラスチックパッケージ	6
メタルパッケージ	8
部門別売上高	10

2022年度 上期・通期の見通し（連結）

上期・通期 業績予想の修正（7/29付）	11
売上高・損益・配当	12

2022年度 設備投資額・減価償却費・研究開発費

14

半導体メモリー向けプラスチックBGA基板の生産能力増強について （7/29付リリース）

15

2022年度 第1四半期決算概要（連結）

決算概況

（単位：億円）

	2021年度 1 Q	2022年度 1 Q	前年同期比	
				増減率
売上高	581	794	+213	37%
営業利益 (営業利益率)	139 (24%)	260 (33%)	+121	87%
経常利益 (経常利益率)	146 (25%)	282 (36%)	+136	93%
純利益※ (純利益率※)	101 (17%)	195 (25%)	+95	94%

※ 親会社株主に帰属する四半期純利益

1株当たり四半期純利益	74.65円	144.71円
-------------	--------	---------

2022年度 第1四半期決算概要（連結）

売上高

- 半導体業界は、中国におけるロックダウンやロシア・ウクライナ紛争、世界的なインフレ進行による影響や、パソコンやスマートフォン需要の減速が懸念されるなど、先行き不透明感が強まる一方で、自動車、産業機器向けなどの需要拡大等を背景に半導体市況は高水準で推移。

当社グループにおいては、フリップチップタイプパッケージ、IC組立、セラミック静電チャック、リードフレーム等の売上増加に加え、為替相場において大幅に円安が進行したことなどから、前年同期比37%増の増収。

損益

- 売上増加に加え、為替相場において大幅な円安が進行したことなどにより、前年同期比93%増の増益。

2022年度 第1四半期決算概要（連結）

セグメント別売上高・経常利益

（単位：億円）

セグメント		2021年度 1Q		2022年度 1Q		前年同期比 増減率 (%)	2021年度	
			構成比(%)		構成比(%)			構成比(%)
売上高 ※1	プラスチックパッケージ	355	(61)	495	(62)	39	1,694	(62)
	メタルパッケージ	204	(35)	273	(35)	34	929	(34)
	その他	22	(4)	26	(3)	17	96	(4)
	合計	581	(100)	794	(100)	37	2,719	(100)
経常利益 ※2	プラスチックパッケージ	109	(31)	193	(39)	77	509	(30)
	メタルパッケージ	42	(21)	98	(36)	134	235	(25)
	その他/調整額	△6		△9			14	
	合計	146	(25)	282	(36)	93	758	(28)

※1 外部顧客への売上高

※2 セグメント間取引調整前の経常利益

2022年度 第1四半期決算概要（連結）

財政状態、設備投資・減価償却費等

（単位：億円）

	2021年度 1 Q	2022年度 1 Q
総資産	2,505	3,374
純資産	1,610	2,190
自己資本比率	64%	65%

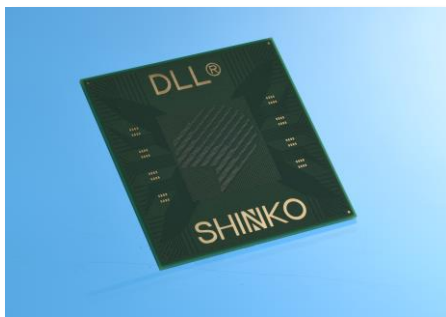
2021年度
3,195
2,020
63%

設備投資額 ※	30	85
減価償却費 ※	44	78
研究開発費	8	9
為替レート(1米ドル)	108円	128円

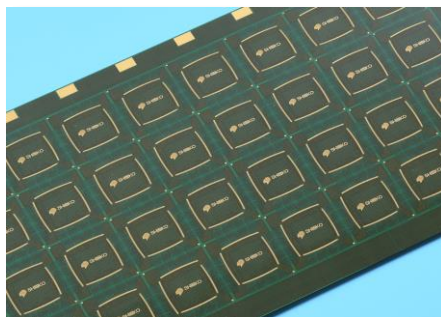
575
300
35
111円

※ 無形固定資産を除く

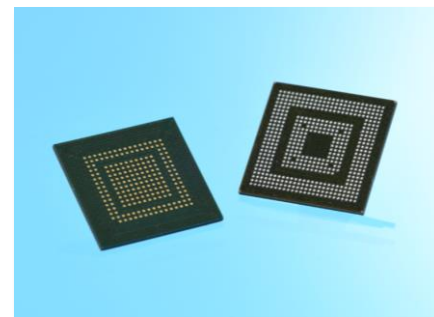
プラスチックパッケージ



フリップチップタイプ
パッケージ



プラスチックBGA基板



IC組立

【主な搭載製品例】

パソコン、サーバー、スマートフォン、民生機器 他

2022年度 第1四半期決算概要（連結）

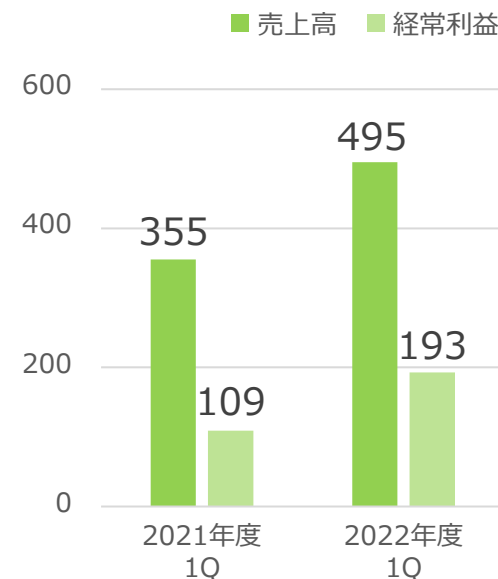
プラスチックパッケージ

（単位：億円）

	2021年度 1 Q	2022年度 1 Q	前年同期比	
			増減額	増減率
売上高（構成比）	355 (61%)	495 (62%)	+140	39%
経常利益（利益率）	109 (31%)	193 (39%)	+84	77%

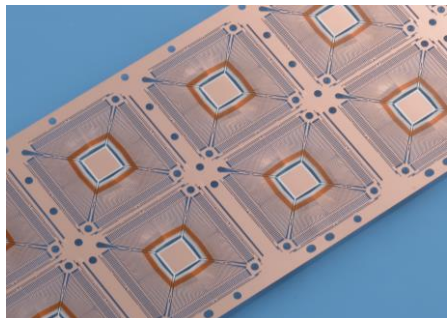
各製品の売上増加と大幅な円安進行により前年同期比増収増益

- フリップチップタイプパッケージは、パソコン向け等の売上が高水準で推移
- IC組立は、ハイエンドスマートフォン向けに需要が大きく増加
- プラスチックBGA基板は、先端メモリー向けの受注が拡大し増収

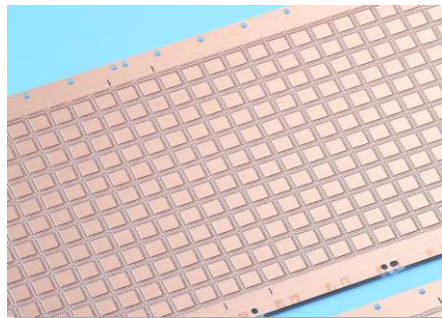


2022年度 第1四半期決算概要（連結）

メタルパッケージ



プレスリードフレーム



エッチングリードフレーム
(QFNタイプ)



セラミック静電チャック



ガラス端子



ヒートスプレッダー

【主な搭載製品例】

自動車、スマートフォン、民生機器、半導体製造装置、通信機器 他

2022年度 第1四半期決算概要（連結）

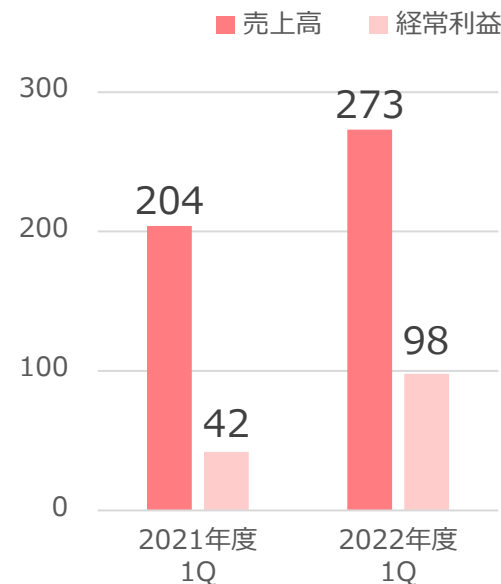
メタルパッケージ

（単位：億円）

	2021年度 1 Q	2022年度 1 Q	前年同期比	
			増減額	増減率
売上高（構成比）	204（35%）	273（34%）	+70	34%
経常利益（利益率）	42（21%）	98（36%）	+56	134%

リードフレーム、セラミック静電チャックなどの売上増加と大幅な円安進行により前年同期比増収増益

- リードフレームは、自動車市場向けの需要が増加したことなどから増収
- セラミック静電チャックは、半導体製造装置市場における旺盛な需要に支えられ売上が大きく増加
- CPU向けヒートスプレッダーは、サーバー向けに売上が増加
- ガラス端子は、光学機器向けが低調に推移し、減収



2022年度 第1四半期決算概要（連結）

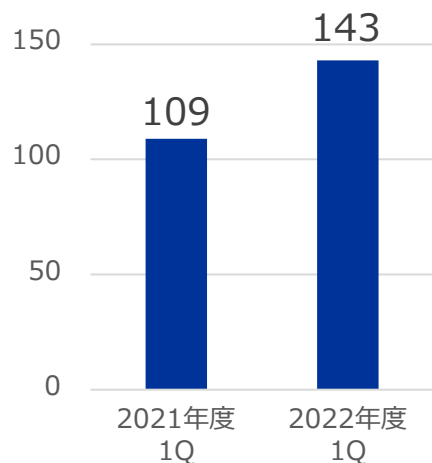
部門別売上高

（単位：億円）

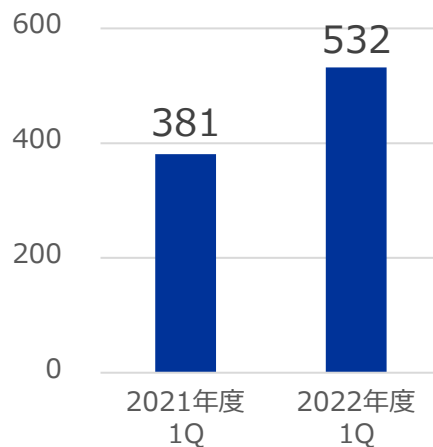
	2021年度 1 Q	2022年度 1 Q	前年同期比		2021年度
				増減率	
ICリードフレーム	109 (19%)	143 (18%)	+34	31%	499 (18%)
ICパッケージ	381 (66%)	532 (67%)	+151	40%	1,808 (67%)
気密部品	90 (16%)	118 (15%)	+28	31%	412 (15%)

※（ ）は構成比

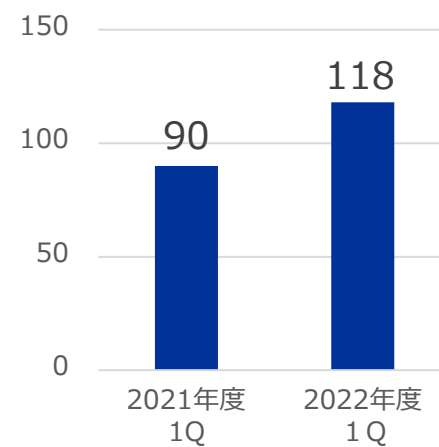
ICリードフレーム部門売上高



ICパッケージ部門売上高



気密部品部門売上高



2022年度 上期・通期の見通し（連結）

上期・通期業績予想の修正（2022年7月29日付）

（単位：億円）

	上期				通期			
	前回予想 (2022/4/28)	今回予想 (2022/7/29)	増減額	増減比	前回予想 (2022/4/28)	今回予想 (2022/7/29)	増減額	増減比
売上高	1,520	1,590	70	5%	3,170	3,220	50	2%
営業利益	400	490	90	23%	850	930	80	9%
経常利益	400	530	130	33%	850	970	120	14%
純利益※	280	370	90	32%	590	670	80	14%
1株当たり当期純利益	207.27円	273.89円	—	—	436.75円	495.97円	—	—

※親会社株主に帰属する当期純利益

修正理由（要旨）

- 第1四半期は、パソコン向けなどにフリップチップタイプパッケージの需要が増加するとともに、プラスチックBGA基板は先端メモリ向けに売上が拡大、為替相場が想定より大幅に円安で推移したことなどから、上期の業績予想に対し、特に利益面において想定を上回って進捗。
- 第2四半期以降は、中国経済の減速や世界的なインフレ、長期化するロシア・ウクライナ紛争の影響などにより、景気の先行き不透明感が強まることが予想され、半導体市場は、パソコンおよびスマートフォンなどの需要減退に伴う在庫調整等が想定される。
- 当社グループにおいては、フリップチップタイプパッケージはパソコン向け等の需要が減少、リードフレームは在庫調整の影響を受け、IC組立はハイエンドスマートフォン向けの需要減退などが見込まれる。
- 一方で、為替相場の動向をふまえ、想定為替レートを第2四半期以降、1米ドル=118円から125円に変更。
- これらにより、4月28日公表の上期および通期業績予想数値を修正。

2022年度 上期・通期の見通し（連結）

売上高・損益・配当

（単位：億円）

	2021年度（実績）			2022年度（予想）			前期比（上段：増減金額、下段：増減比率）		
	上期	下期	通期	上期	下期	通期	上期	下期	通期
売上高	1,259	1,460	2,719	1,590	1,630	3,220	331 (26%)	170 (12%)	501 (18%)
営業利益 (営業利益率)	301 (24%)	413 (28%)	714 (26%)	490 (31%)	440 (27%)	930 (29%)	189 (63%)	27 (6%)	216 (30%)
経常利益 (経常利益率)	316 (25%)	443 (30%)	758 (28%)	530 (33%)	440 (27%)	970 (30%)	214 (68%)	△3 (△1%)	212 (28%)
純利益※1 (当期純利益率※1)	217 (17%)	309 (21%)	526 (19%)	370 (23%)	300 (18%)	670 (21%)	153 (70%)	△9 (△3%)	144 (27%)
為替レート	111円/\$			128 円/\$※2	125円/\$ (2~4Q想定)				

※1 親会社株主に帰属する当期純利益

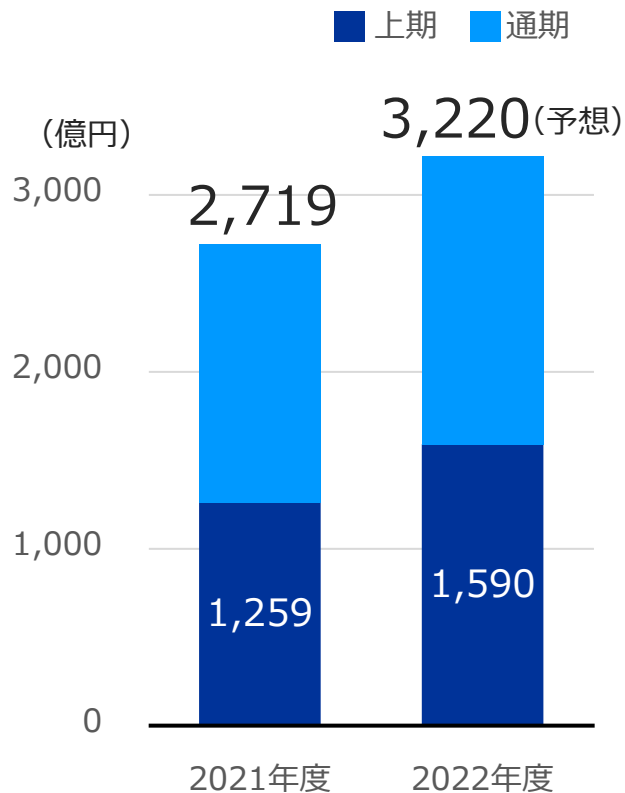
※2 2022年度1Q実績

（単位：円）

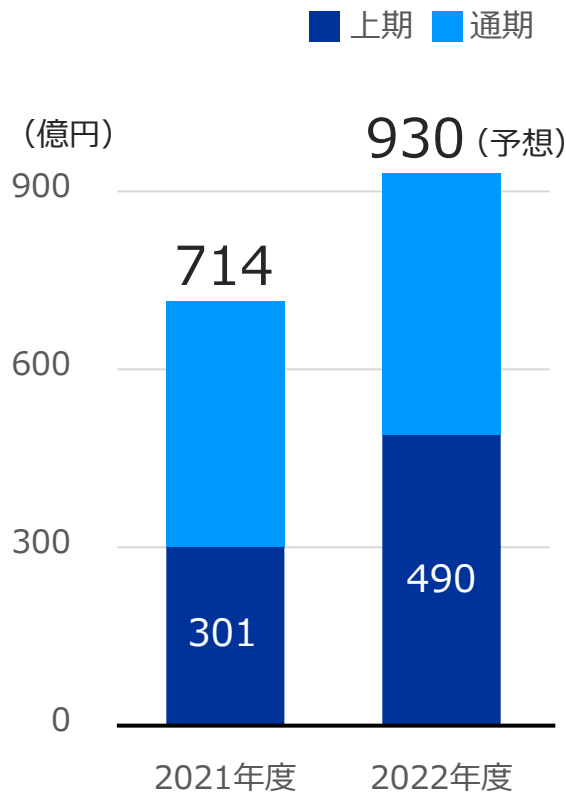
1株当たり配当金 (配当性向)	17.5 [中間]	27.5 [期末]	45.0 (11.6%)	25.0 [中間]	25.0 [期末]	50.0 (10.1%)
--------------------	--------------	--------------	-----------------	--------------	--------------	-----------------

2022年度 上期・通期の見通し（連結）

売上高

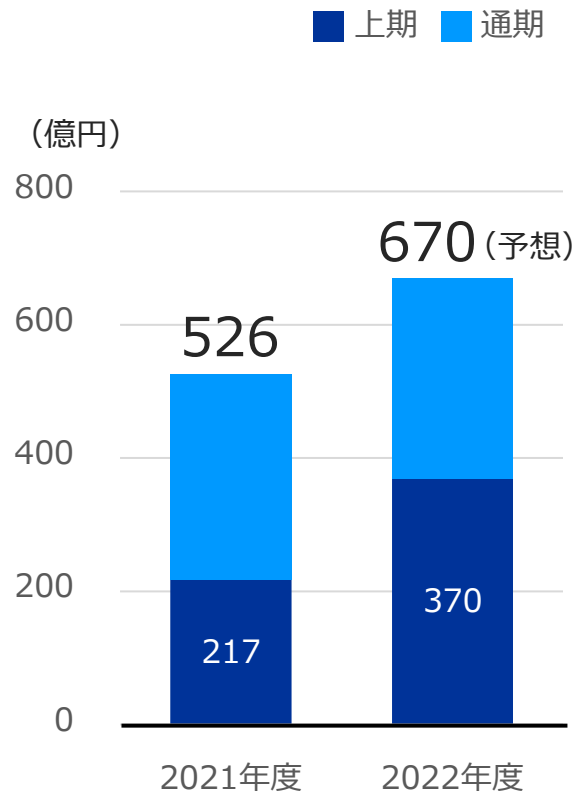


営業利益



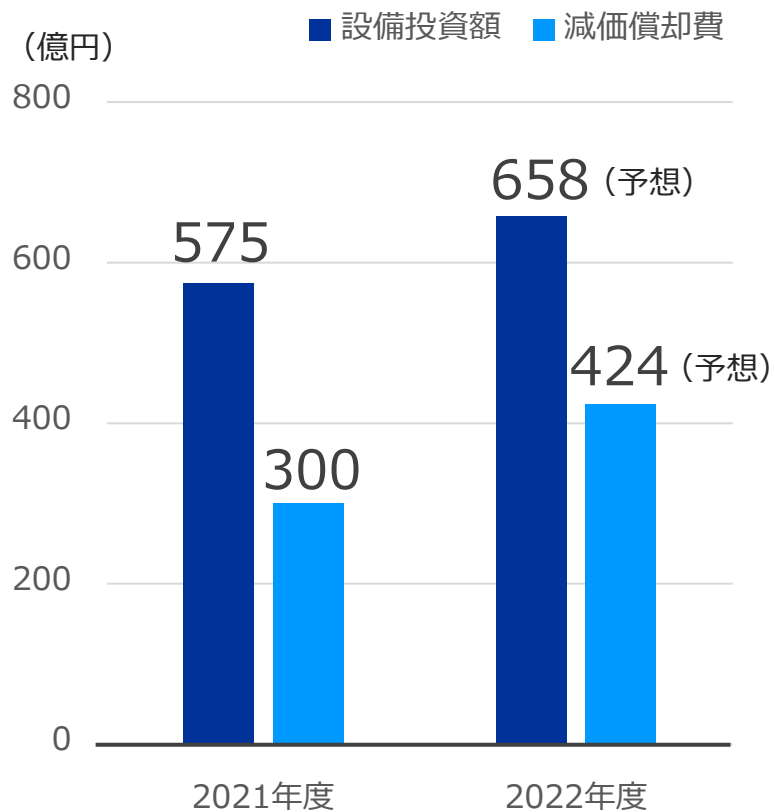
純利益※

※親会社株主に帰属する当期純利益

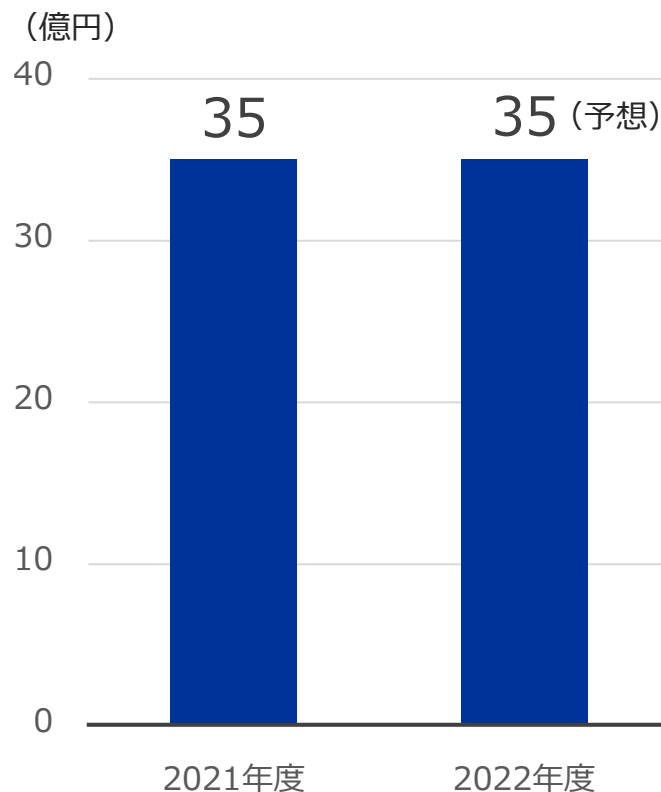


2022年度 設備投資額・減価償却費・研究開発費

設備投資額・減価償却費



研究開発費



半導体メモリー向けプラスチックBGA基板の

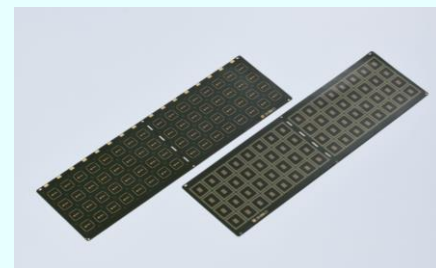
生産能力増強について 2022年7月29日付リリース（要旨）

今後、AI、IoTの活用の進展、5Gの普及等による飛躍的なデータ通信量の増加や、インフォテインメントシステムをはじめとする自動車のさらなる電装化等を背景として、半導体メモリーは高速・大容量化がさらに進み、需要拡大が見込まれるとともに、一層の微細・薄型・低電力のニーズが高まることが想定されます。当社は、これらに対応することを目的として、微細化・薄型化の先行技術MSAP工法によるプラスチックBGA基板の生産能力増強をはかるべく、当社新井工場（新潟県妙高市）内に新棟を建設することといたしました。

【設備投資の概要（予定）】

- (1) 対象製品：半導体メモリー向けプラスチックBGA基板
- (2) 投資額：280億円
- (3) 生産能力：本設備投資により半導体メモリー向けプラスチックBGA基板の生産能力は、既存棟において既に設備投資に着手している新ライン（2023年度稼働予定）による寄与分を含め、現行比約2倍程度に増強することを見込んでおります。
- (4) 新棟概要：

①所在地	新井工場内（新潟県妙高市）
②建物構造	鉄骨造り 3階建て（一部4階）
③延床面積	14千㎡
④スケジュール	2024年度 着工 2025年度 竣工 2026年度 稼働開始



プラスチックBGA基板

※本設備投資計画による2023年3月期連結業績に与える影響は軽微であります。

※本投資計画の詳細は2022年7月29日発表の「半導体メモリー向けプラスチックBGA基板の生産能力増強について」をご覧ください。 https://www.shinko.co.jp/news/docs/20220729_02_j.pdf

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手可能な情報および合理的と判断する一定の前提に基づくものであり、将来の予想数値の実現を保証するものではありません。実際の業績は、今後さまざまな要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。

また、本資料では、業績の概略として多くの数値は億円単位にて表示しております。決算短信等で百万単位で開示しております数値を丸めて表示しているため、本資料に表示されている合計額、差額などが1億円の桁において、不正確と見える場合があります。詳細な数値が必要な場合は、決算短信または四半期報告書を参照していただきますようお願いいたします。